

大気リフロー対応ボイド対策品

PF305-150TO(A)

◆ 大気雰囲気でも大面積下のボイド発生を低減

	銅チップ (5mmx5mmx0.5mm)		パワートランジスタ (5mmx5mm)	
	従来品	PF305-150TO (A)	従来品	PF305-150TO (A)
X線写真				
ボイド率	<p>従来品 18% PF305-150TO (A) 3% 従来比マイナス83%</p>		<p>従来品 25% PF305-150TO (A) 6% 従来比マイナス76%</p>	
<p><試験条件> ・メタルマスク厚：100μm ・予備加熱：150-190℃ 90sec ・ピーク温度：240℃</p>				

◆ 劣化基板で過酷なリフロー条件下でも良好な濡れ性

濡れ離れあり
従来品

濡れ離れなし
PF305-150TO (A)

<試験条件>

- 試験基板：酸化銅板
- メタルマスク厚：200μm、印刷径6.5mmφ
- リフロー雰囲気：大気
- 予備加熱：200℃、90sec
- ピーク温度：240℃

◆ 良好なはんだ濡れ性によるブリッジ・はんだボールの減少

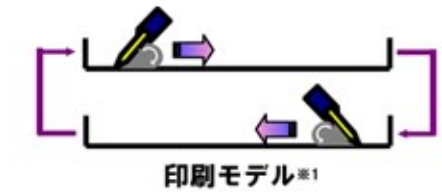
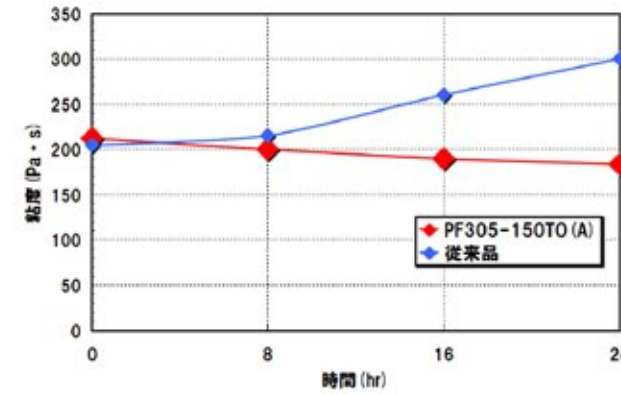
印刷モデル

ブリッジ
濡れ不足
はんだボール
従来品

はんだ切れ良好
PF305-150TO (A)

<試験条件>
 ・試験基板：JIS II 櫛型電極基板
 ・リフロー雰囲気：大気
 ・メタルマスク厚：100μm
 ・予備加熱：150-190℃、90sec
 ・ピーク温度：240℃

◆ 24時間連続印刷時の粘度変化を低減



<試験条件>

- スキージ：平型ウレタンスキージ 硬度90
- 角度：60°
- スピード：20mm/sec
- 圧力：13.0×10⁻² N

※1 目止めたメタルマスク上で連続してスキージを動かし、擬似的な印刷を行っております。

◆ 各種洗浄液で良好な洗浄性※2

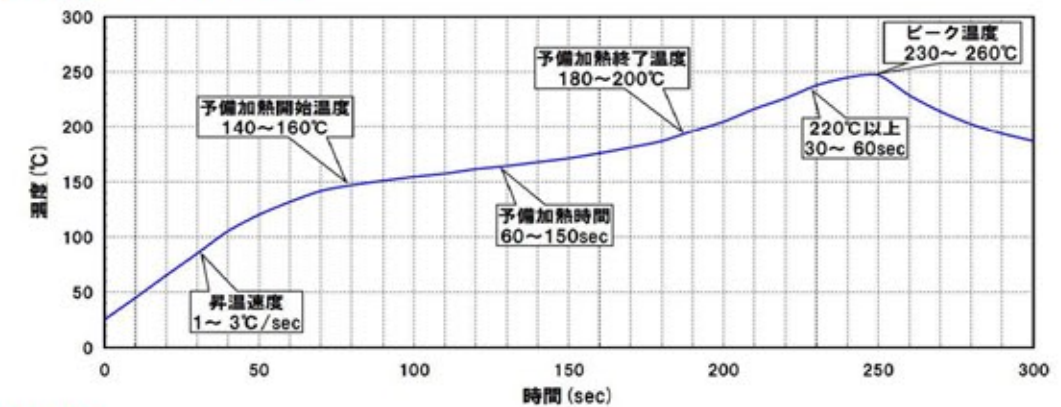


<試験条件>

- 試験基板：ガラスエポキシ基板
- 予備加熱：150℃、60sec
- 洗浄方法：攪拌
- メタルマスク厚：200μm
- ピーク温度：260℃、30sec
- 洗浄温度：60℃
- リフロー雰囲気：大気
- 洗浄時間：120sec

※2 無洗浄でもご使用可能です。JIS Z 3284に準拠した絶縁抵抗試験の結果は、基準値以上の値を示しております。

◆ 推奨温度プロファイル



◆ 一般特性

項目	代表特性	試験方法
合金組成	Sn-3.0Ag-0.5Cu	-
粒度	20~38 μm	-
フラックス含有量	11.5%	JIS Z 3197
フラックスタイプ	ROLO	IPC-J-STD-004
ハロゲン含有量	0.02%	配合値
粘度/Ti値	200Pa·s/0.51	JIS Z 3284

※上記特性値は代表値で保証値ではありません。